

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2026-098

转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及提供借款

实施募投项目到期续借的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026年10月26日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“奥特维”或“公司”）召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

董事会授权公司管理层在上述授权额度范围及期限内行使投资决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责实施。保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

一、 募集资金基本情况

（一）2022 年公司向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1250 号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A 股）770.46 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 68.79 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 53,000.00 万元，扣除本次发行费用人民币 552.83 万元，募集资金净额为人民币 52,447.17 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 22 日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0030 号）。

（二）2023 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1523 号”文《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行面值总额为人民币 114,000.00 万元的可转换公司债券。募集资金总额为人民币 114,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 708.68 万元后，实际募集资金净额为人民币 113,291.32 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 16 日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“立信中联验字【2023】D-0025 号”

《验资报告》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》

二、 募集资金投资的相关情况

（一）2022年公司向特定对象发行股票

根据《无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》以及《无锡奥特维科技股份有限公司关于部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构以及实施期限的公告》（公告编号：2024-100），公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金调整后的项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高端智能装备研发及产业化	30,850.77	29,000.00
1.1	TOPCon 电池设备	10,850.77	9,600.00
1.2	半导体封装测试核心设备	15,000.00	14,700.00
1.3	锂电池电芯核心工艺设备项目	5,000.00	4,700.00
2	科技储备资金	15,000.00	15,000.00
3	补充流动资金	9,000.00	8,447.17
合计		54,850.77	52,447.17

注：补充流动资金实际投资金额为 8,526.20 万元，超出拟投入募集资金投资金额，主要系购买银行理财产品收益及银行活期存款利息收入。

（二）2023年公司向不特定对象发行可转换公司债

根据公司披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》，以及实际收到的募集资金净额，本次发行募集资金拟投入以下项目的建设：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	平台化高端智能装备智慧工厂	105,941.90	103,291.32
2	光伏电池先进金属化工工艺设备实验室	7,000.00	6,000.00
3	半导体先进封装光学检测设备研发及产业化	5,000.00	4,000.00
合计		117,941.90	113,291.32

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

董事会授权公司管理层在上述授权额度范围及期限内行使投资决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（八）对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合法律法规、确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效控制募

集资金风险的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

（九）投资风险及控制措施

公司本次现金管理，仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司制定了如下风险控制措施，以保证不影响募投项目正常进行：

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；

4、公司内审部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；

5、公司审计委员会、独立董事有权对现金管理资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计；

6、公司将依据相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露的义务。

四、关于提供借款实施募投项目到期续借的情况

（一）前期使用募集资金向子公司提供借款的情况

公司于2022年11月23日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金10,000万元向无锡奥特维光学应用有限公司（以下简称“光学应用”）提供无息借款以实施募投项目“高端智能装备研发及产业化之半导体封装测试核心设备项目之‘装片机’、‘倒装芯片键合机’项目”，借款期限为自实际借款之日起4年，到期前可提前偿还。

公司于2023年11月8日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》，同意因光学应用实施股权激励，使得“高端智能装备研发及产业化之半导体封装测试核心设备项目之‘装片机’、‘倒装芯片键合机’项目”的实施主体由公司的全资子公司变更为控股子公司，相关募集资金借款从无息借款调整为有息借款，借款利率参考同期贷款市场报价利率，光学应用已有募集资金借款自公司股东大会审议通过之日起计息，未来募集资金借款自借款到账之日起计息，少数

股东将不提供同比例借款。

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第五十三次会议、第三届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于控股子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意控股子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（以下简称“科芯半导体”）对控股子公司光学应用实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，作为合并方的科芯半导体继续存续，合并后科芯半导体的公司名称、类型、经营期限保持不变，经营范围变更为科芯半导体与光学应用现有经营范围的相加；作为被合并方的光学应用解散注销，其资产、负债、业务以及人员全部由科芯半导体依法承继。原由公司的控股子公司光学应用实施的募投项目“高端智能装备研发及产业化之半导体封装测试核心设备项目之‘装片机’、‘倒装芯片键合机’项目”，实施主体变更为科芯半导体。

“高端智能装备研发及产业化之半导体封装测试核心设备项目之‘装片机’、‘倒装芯片键合机’项目”已分别于 2026 年 3 月、2026 年 8 月完成结项。截至目前，上述募投项目相关的募集资金借款待偿还本金金额为 5,000.00 万元。

（二）本次借款到期续借的基本情况

上述借款即将到期，鉴于“高端智能装备研发及产业化之半导体封装测试核心设备项目之‘装片机’、‘倒装芯片键合机’项目”尚未产生经济利益，且“高端智能装备研发及产业化之半导体封装测试核

心设备项目”尚未整体结项，结合科芯半导体的财务状况，公司拟对该笔借款待偿还的 5,000.00 万元进行到期续借，期限 36 个月，借款利率参考同期贷款市场报价利率，少数股东将不提供同比例借款。

相关募集资金借款将继续专项用于上述募投项目的尾款支付，不得用作其他用途，公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的要求规范使用。科芯半导体可根据项目实际情况提前偿还，董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

（三）借款对象基本情况

1、借款对象公司名称：无锡奥特维科芯半导体技术有限公司

2、成立时间：2022年1月11日

3、统一社会信用代码：91320214MA7GTGT439

4、注册地址：无锡市新吴区珠江路25号

5、注册资本：3250.74万元人民币

6、法定代表人：陈进

7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器

仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开发；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息系统集成服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：上市公司持股比例为73.5866%，无锡奥融企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为7.6906%，陈进持股比例为6.1524%，无锡璟同企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为3.6915%，无锡奥能企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为3.5515%，无锡萃益企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为3.5515%，无锡璟和持股比例为1.7759%。

9、经营情况：科芯半导体最近一年一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
资产总额	53,003.33	30,447.46
负债总额	74,103.99	47,870.28
净资产	-21,100.66	-17,422.82
项目	2026年1-9月	2025年度
营业收入	11,848.83	10,419.72
净利润	-3,901.65	-9,197.57

注：上述2025年度/2025年末的财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-9月/9月末的财务数据未经审计。

10、失信被执行人情况：科芯半导体不属于失信被执行人。

（四）本次借款到期续借对公司的影响

本次提供借款实施募投项目到期续借不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

五、相关审议程序

公司于 2026 年 10 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会第二十次会议，2026 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常开展的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2、《关于提供借款实施募投项目到期续借的议案》，同意公司对控股子公司科芯半导体待偿还的 5,000.00 万元借款进行到期续借，续借期限为 36 个月，借款利率参照同期贷款市场报价利率确定，少数股东不按其持股比例提供同比例借款。上述募集资金借款将继续专项用于相关募投项目的尾款支付，不得挪作他用。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，规范使用募集资金。科芯半导体可根据募投项目实际进展情况提前偿

还上述借款。董事会同意授权公司经营管理层全权负责本次借款相关手续办理及后续管理工作。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：无锡奥特维科技股份有限公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及提供借款实施募投项目到期续借的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构对使用暂时闲置募集资金进行现金管理及提供借款实施募投项目到期续借的事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及提供借款实施募投项目到期续借的核查意见》

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日